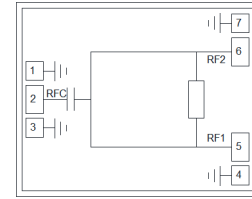


性能特点

- 频率范围：0.5–2GHz
- 插入损耗：0.9 dB
- 隔离度：18 dB
- 芯片尺寸：1.40X1.02X0.1 mm
- 100%在片测试

功能原理图



产品介绍

ZXA6507是一款单片集成2路功分器芯片 (Die),频率范围覆盖0.5–2GHz, 插入损耗0.9dB, 回波损耗-15dB, 隔离度典型值18dB。芯片采用了片上通孔金属化工艺, 保证了良好的接地; 芯片背面进行了金属化处理, 适用于导电胶粘接或共晶烧结工艺。

电气性能参数 (TA = +25℃)

参数	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	0.5		2	GHz
插入损耗		0.9		dB
隔离度		18		dB
回波损耗		-15		dB

使用限制参数

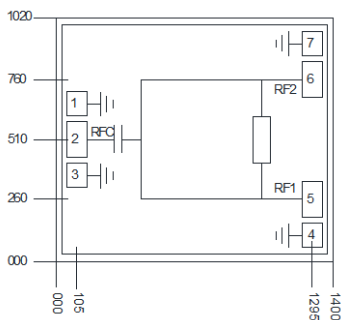
项目	数值
RFC	30 dBm
RF1, RF2	27 dBm
工作温度	-55 ~ +85 ℃
储存温度	-65 ~ +150 ℃



该产品对静电较敏感
使用中请注意防静电

*超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏

键合点定义



管脚	名称
2	RF C
5	RF 1
6	RF 2
其他	GND

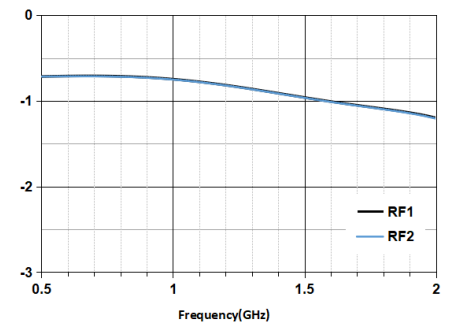
说明 1. RF PAD:100um*150um

装配说明:

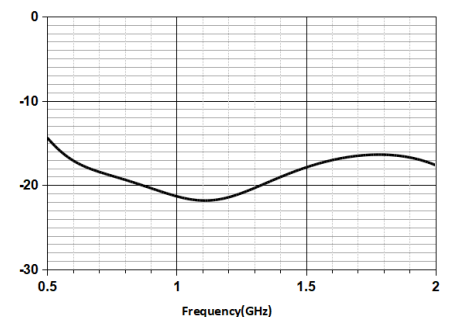
1. 芯片厚度100um。
2. 在净化环境装配使用, 不要碰触表面, 以免损伤芯片。
3. 输入输出使用2根金丝键合 (直径25um), 键合线尽量短, 不要长于400um。
4. 用Au80Sn20 金锡烧结, 温度不要超过300℃, 烧结时间不要超过 30 秒。
5. 本品属于静电敏感器件, 储存和使用时注意防静电。
6. 干燥、氮气环境下保存。

典型测试曲线

插入损耗 VS 频率



隔离度 VS 频率



回波损耗 VS 频率

